

設備名

C A E システム (A N S Y S)

用途

構造解析や流体解析、磁場解析及び連成解析を行うことが出来る
C A E 解析システムです。

写真



A N S Y S

アンシス・ジャパン株式会社

仕様

ハードウェア : CIARA Technologies KRONOS S810

ソフトウェア : ANSYS Multiphysics-Bundled TECS

ソフトウェア : ANSYS DesignModeler-Bundled TECS

設備名

C A E システム (J S T A M P)

用途

プレス成形シミュレーションを行うことが出来る C A E システム
です。

写真



J S T A M P
株式会社 J S O L

仕様

ハードウェア : HP Z420/CT Workstation
LJ449AV-BWZW

ソフトウェア : JSTAMP/NV

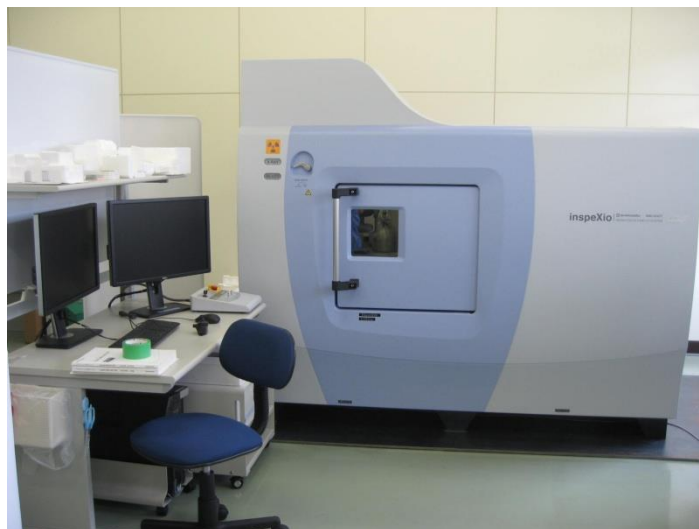
設備名

マイクロフォーカス X 線 CT システム
(i n s p e X i o S M X - 2 2 5 C T)

用途

非破壊によりサンプル内部の 3 次元構造を観察することが出来る X 線 CT システムです。

写真



マイクロフォーカス X 線 CT システム
i n s p e X i o S M X - 2 2 5 C T
株式会社島津製作所

仕様

X 線発生装置 開放型： 定格 135W
最大管電圧： 225kV
最大管電流： 1000 μ A
X 線検出器： イメージインテンシファイア
CT ステージ最大ストローク S O D 軸： 670 mm
S I D 軸： 400、600、800、1000
mm の 4 段切替
Z 軸： 300 mm
搭載可能サンプルサイズ： ϕ 300 \times H300 mm、最大 9kg
最大 CT スキャン領域 (FOV)： ϕ 200 mm
スキャン方式： ノーマルスキャン、ハーフスキャン、オフセット
スキャン、FS スキャン、
2 D C T / C B C T
CT データ収集時間： 3 秒から 30 分まで任意設定可能
CT 画像サイズ： 512 \times 512、1024 \times 1024、2048 \times 2048

設備名

レーザー加工機
(2kw ファイバーレーザー発振器 YLS-2000-CT)

用途

ファイバーレーザーによる溶接やマーキングなどをさまざまな材料に加工することが出来るレーザー加工装置です。

写真



レーザー加工機
株式会社レーザックス

仕様

加工装置 軸ストローク： X = 500 mm、Y = 500 mm、Z = 150 mm
繰り返し位置決め精度： ±20 μ m
テーブルサイズ： 300 mm × 300 mm
テーブル最大速度： 200 mm/sec

レーザー発振器 最大出力： 2000W
ファイバーコア径： 100 μ m
波長： 1070～1080nm
オペレートモード： CW
変調周波数： 最大 5kHz

固定加工ヘッド コリメーションレンズ： f=100 mm
フォーカシングレンズ： f=150 mm
焦点位置スポット径： φ 150 μ m

ガルバノスキャンヘッド コリメーションレンズ： f=100 mm
Fθレンズ： f=340 mm
焦点位置スポット径： φ 340 μ m
スキャンエリア： 200 mm × 200 mm
スキャン最大速度： 6000 mm/sec

設備名

CADシステム
(3次元CADビューワー)

用途

見積・工法検討・データ変換・加工指示・検査等ものづくりの製造工程を支える3Dデータハンドリングツールです。

機能として、表示機能・計測機能・3Dスケッチ機能・図面化機能・モデル操作機能等があります。

写真



3DTascalX
株式会社シーセット

仕様

ハードウェア： HP Z420/CT Workstation
LJ449AV-BWZW

ソフトウェア： 3DTascalX
CATIA V5(R/W)